

QCW 光纤激光微细切割钻 孔机简要说明



型号：Super-Drilling 600F

QCW 光纤激光微细切割 钻孔系统

规格参数

型号：Super-Drilling 600F

行业应用

- 1、陶瓷手机背板外形切割&听筒音孔钻孔；
- 2、LED&汽车电路陶瓷基板划片、切割、钻孔；
- 3、精密金属结构件外形切割、钻孔；
- 4、钟表齿轮&眼镜外框精密外形切割。

机器优点

- 1、高功率激光器，对厚度 2mm 以下的陶瓷基板或薄金属片均可进行切割钻孔，最小孔径可达 100um。
- 2、进口直线电机运动平台，有效行程 500mm × 350mm，重复精度为 1 μm，定位精度 ≤ ±3 μm。
- 3、激光切割头 Z 轴动态调焦自动补偿及吹气冷却功能。
- 4、CCD 视觉自动抓靶定位，支持多种视觉定位特征。
- 5、自助研发软件 strongcut，激光能量在软件中可调节控制。

序号	项目	技术参数
光学单元		
1	激光器类型	1064nm
2	激光功率	150W-500W 可选
3	光束质量	M ² <1.3
4	聚焦方式&加工头数	单点聚焦镜、单头
5	最小聚焦光斑直径	Φ 10 μm
激光加工性能		
6	加工速度	0-300mm/s 可调
7	最小崩边	10 μm
8	最大加工材料厚度	2mm
9	最大加工尺寸&精度	500mm × 350mm, ±5 μm